



2012年4月27日

各位

会社名 日立化成工業株式会社
代表者名 執行役社長 田中一行
(コード番号: 4217 東証・大証第一部)
問合せ先 CSR統括部コーポレートコミュニケーションセンター長
加藤 淳
電話番号 03-5381-2370

半導体用封止材事業(光半導体向け封止材事業を除く。)の譲受に関する
事業譲渡(譲受)契約締結のお知らせ

当社は、2012年3月30日付「半導体用封止材事業(光半導体向け封止材事業を除く。)の譲渡(譲受)に関する基本合意のお知らせ」で公表しました、日東電工株式会社(以下「日東電工」という。)からの事業の譲受に関しまして、4月開催の当社取締役会にて決議し、本日事業譲渡(譲受)契約を締結しましたので、お知らせいたします。事業譲受の内容および日程等公表した内容に変更はありません。

記

1. 事業譲受の概要

(1) 事業譲受の内容

- ① 日東電工の国内の対象封止材事業の製造拠点である日東エレクトロニクス九州株式会社の全株式
- ② 日東電工の海外(マレーシア)の対象封止材事業の製造拠点である NITTO DENKO ELECTRONICS (MALAYSIA) SDN. BHD. の全株式
- ③ その他日東電工の対象封止材事業に係る資産・負債・契約等

および、対象封止材事業遂行に必要な人員。

(2) 譲受価額

54億円。ただし、譲受時の資産・負債および為替等の状況により、変動の可能性があります。

2. 今後の日程

2012年10月1日(予定) 事業譲受期日

なお、本事業譲受につきましては、必要な許認可を全て取得することを条件として実施する予定です。

3. 今後の見通し

本件による、当社の業績および財政状態に与える影響は軽微であると想定しております。

以上